



## 产品技术参数规格

### ZH 8405 导电性胶粘剂

#### 1 产品简介:

昭华科技 ZH 8405 导电银胶可粘接金、银、铜、钯、硅、陶瓷等同种或异种材料,适用于 IC、comos、三极管等半导体元器件封装工艺,适合 dispenser, pin trains for 等各种点胶工艺,具有低模量,极少的溢流,粘接力强等特点。

#### 2 产品特点:

- (1) 单组分,使用工艺简单,操作方便;
- (2) 纯度高,杂质离子含量低;
- (3) 导电率高,导电性能稳定;
- (4) 粘结强度高,与多种基材都具有优良的粘接性能;
- (5) 储存稳定性好,受环境因素影响小等;
- (6) 可以满足微电子厂家要求波峰焊的高温粘结性能。

Typical Uncured Properties 参数名称		ZH 8405	Test Description 测试方法描述	Test Method 测试方法
Filler type	填充料	Ag		
Viscosity @ 25°C	粘度	6000-8000 cps	ZH-087	ATM-0018
Thixotropic index	触变指数	> 5	ZH-032	ATM-0089
Work life @ 25°C	工作时间	36 hours	ZH-053	ATM-0087
Storage life @ -40°C	储存时间	>6 months		ATM-0068
Weight loss on cure	热失重	3%	ZH-044	ATM-0073
Recommended cure condition 建议烘烤条件		Ramp to @ 120°C/30min+175°C/45min		
Ionics	Chloride Cl <sup>-</sup>	< 0.1 ppm	ZH-032	ATM-0007
	Sodium Na <sup>+</sup>	< 5 ppm		
	Potassium K <sup>+</sup>	< 0.2 ppm		
Thermal Conductivity	导热系数	2.8 W/mK	ZH-018	ATM-0116
Instantaneous temperature	瞬间高温	275°C	ZH-014	ATM-0073
Volume Resistivity	电阻率	4×10 <sup>-4</sup> ohm-cm	ZH-035	ATM-0082
Die shear strength (N/m <sup>2</sup> ) (Post cure)	推力测试	≥8×10 <sup>7</sup>	ZH-042	ATM-0052



## 包装规格:

18g/支(5CC)、30g/支(10CC)、100g/瓶、200g/瓶、500g/瓶, 特殊包装规格需另商议。


## 储存条件:

冷冻状态下-15℃至-40℃存储, 室温下解冻 30-60 分钟后均匀搅拌后才可使用, 针筒包装免搅拌, 未用完的胶水需严格密封后再冷藏。

## 重要声明:

本产品样本中提供的技术参数仅供参考, 以上数据信息是基于在环境温度 25℃、相对湿度 70%环境下对产品测试所得到的典型数据, 以便广大客户使用时提供可能的建议。

它们会随不同的工况条件, 如设备类型、材质、工艺条件等改变。

我公司商标为 , 如非我公司标签产品, 请勿参照此说明书, 因此引起的任何后果, 我司将不承担任何责任。

使用产品之前, 请仔细阅读材料安全资料、产品及产品使用说明。使用者应先确定产品是否符合所需之用途, 需承担使用这些产品有关之风险和责任。卖方不向使用者或其他有关人士承担因使用(包括不当使用)卖方的产品而引起的伤害或任何直接、间接、意外或后续性损失的责任。